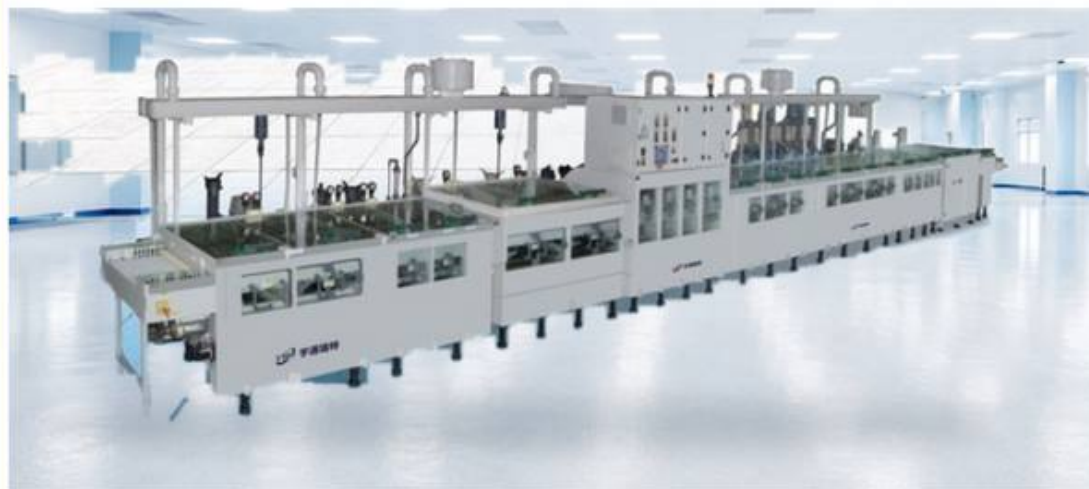


ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Горизонтальные и вертикальные линии мокрых процессов
для PCB, FPCB, керамических подложек и полупроводников.



НАДЁЖНОСТЬ

Стабильные процессы

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Интеграция с MES

СЕРВИС

Поддержка и обучение

ЛИНИЯ OSP



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прозрачные панели для контроля технологического процесса.
- Насосы высокого давления для равномерного нанесения.
- Тонкая и равномерная органическая защитная плёнка.
- Контроль температуры и концентрации.
- Интеграция с MES.

НАЗНАЧЕНИЕ

Защита открытой меди органическим паяемым покрытием OSP.

ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ



ПОСТОБРАБОТКА ПОСЛЕ HASL

15



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прозрачные панели и удобный контроль процесса.
- Регулируемая высота рабочих секций.
- Автоматическая фильтрация раствора.
- Промывка DI-водой и равномерная сушка.
- Интеграция с MES.

НАЗНАЧЕНИЕ

Удаление остатков флюса и продуктов обработки после HASL.

ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

